

电子封装与互连手册



[电子封装与互连手册_下载链接1](#)

著者:Charles A.Harper 编

出版者:

出版时间:2009-6

装帧:

isbn:9787121088445

电子封装与互连已成为现代电子系统能否成功的关键限制因素之一，是在系统设计的开

始阶段就必须进行综合设计的考虑因素。《电子封装与互连手册(第4版)》第一部分包含电子封装的基本技术，即当代电子封装常用的塑料、复合材料、粘结剂、下填料与涂敷料等封装材料，热管理，连接器，电子封装与组装用的无铅焊料和焊接技术；第二部分为电子封装的互连技术，包含焊球阵列、芯片尺寸封装、倒装芯片粘结、多芯片模块、混合微电路等各类集成电路封装技术及刚性和挠性印制电路板技术；第三部分为高速和微波系统封装。

作者介绍:

目录:

[电子封装与互连手册_下载链接1](#)

标签

电子封装与互连手册

封装

可靠性

IC

评论

[电子封装与互连手册_下载链接1](#)

书评

[电子封装与互连手册_下载链接1](#)